



# 国际电工委员会质量评定体系 (IECQ)

IECQ 规则及详情, 请登陆 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## 独立实验室批准证书

### 范围附件

IECQ 证书号: IECQ-L CEP 24.0001-01

CB 证书号: IECQ-L 2024.006

附件号: IECQ-L CEP 24.0001-01-S

版本号: 4

颁发日期: 2025/08/22

第 1 页 共 2 页

序号	产品/产品类别	项目/参数		检测标准(方法)名称及编号(含年号)
		序号	名称	
1	电工电子产品/ 电子半导体产品	1	恒定湿热试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》 GB/T 2423.3-2016 《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Cy: 恒定湿热主要用于元件的加速试验》 GB/T 2423.50-2012
		2	温度循环试验	《环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 N: 温变变化》 GB/T 2423.22-2012
		3	温度存储试验	《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 A: 低温》 GB/T 2423.1-2008 《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 B: 高温》 GB/T 2423.2-2008
		4	外观目检	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 2009.2
		5	开封实验	军用电子元器件破坏性物理分析方法 GJB-4027B-2021 中 1103 中 2.6.2
		6	去层试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.3.3
		7	电性验证试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.2.3.3.2.4
		8	红外扫描试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.4 (d)
		9	探针试验	微电子器件试验方法和程序 GJB-548C-2021 方法 5003 中 3.2.12
		10	声学扫描显微镜 检查	军用电子元器件破坏性分析物理分析方法 GJB-4027B-2021 中方法 1103 中 2.5
2	非密封表面贴装 器件/电子半导 体产品	1	预处理试验	《非密封表面贴装器件在可靠性测试之前的预处理方法》 JSED22-A113I-2020 条款 5
				《非密封表面贴装器件在可靠性测试之前的预处理方法》 J-STD-020F-2022 条款 5
				《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J
				《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-REV-E

本附件与引用的证书同时使用时有效

本证书与附件如需复制使用, 应确保其完整性

本证书不得转让, 归发证机构管理

验证本证书与附件的状态和真实性可登陆 [www.iecq.org](http://www.iecq.org) 查询

广州赛宝认证中心服务有限公司  
广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 (511370)





# 国际电工委员会质量评定体系 (IECQ)

IECQ 规则及详情, 请登陆 [www.iecq.org](http://www.iecq.org)

## 独立实验室批准证书

### 范围附件

IECQ 证书号: IECQ-L CEP 24.0001-01

CB 证书号: IECQ-L 2024.006

附件号: IECQ-L CEP 24.0001-01-S

版本号: 4

颁发日期: 2025/08/22

第 2 页 共 2 页

	2	温湿度偏压	《稳态温湿度偏压寿命试验》 JESD22-A101D.01-2021 条款 4
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J
	3	高温偏压试验	《温度、偏压和工作寿命》 JESD22-A108G-2022 条款 4
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J
	4	高温存储试验	《高温存储寿命测试》 JESD22-A103E.01-2021 条款 4
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J
	5	高加速应力试验	《加速抗湿-无偏压高加速应力试验》 JESD22-A118B.01-2021 条款 4
			《高加速温湿度试验》 JESD22-A110E.01-2021 条款 4
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J
			《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-REV-E
	6	高压蒸煮试验	《无偏置电压高压力蒸煮》 JESD22-A102E-2015 条款 4
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J
			《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-REV-E
	7	温度循环试验	《温度循环测试》 JESD22-A104F.01-2023 条款 4, 条件 B,C
			《基于集成电路应力测试认证的失效机理》 AEC-Q100-REV-J
			《基于失效机制的汽车离散 半导体应力测试鉴定》 AEC-Q101-REV-E

本附件与引用的证书同时使用时有效

本证书与附件如需复制使用, 应确保其完整性

本证书不得转让, 归发证机构管理

验证本证书与附件的状态和真实性可登陆 [www.iecq.org](http://www.iecq.org) 查询

广州赛宝认证中心服务有限公司  
广州市增城区朱村街朱村大道西 76 号 (511370)

